

W-GM-5200

Wafer Edge Grinding Machine



株式会社 東精エンジニアリング

W-GM-5200 仕様

基本仕様

ウェーハサイズ	φ 300 mm
ウェーハの厚さ	0.6 ~ 1.0 mm
ウェーハ形状	φ 300 mm (ノッチ付き)
外周研削	
砥石外径 溝部	φ 200 mm
砥石外径 外周	φ 202 mm
砥石内径	φ 30 mm
砥石フランジ厚	20 mm
砥石周速	5000 min ⁻¹ (最大)
スピンドル軸受け方式	グリース潤滑・メカニカル軸受け方式
スピンドル駆動方式	ビルトインモータ方式
研削スピード	任意設定可能
ノッチ研削	
砥石外径 溝部	φ 1.8 ~ 2.4 mm
砥石外径 外周	φ 3.8 mm
砥石シャンク径	φ 3 mm
砥石回転数	80000 min ⁻¹
スピンドル軸受け方式	エア軸受け方式
スピンドル駆動方式	エアタービン方式
研削スピード	0.1 ~ 1.0 mm / sec
シグナルタワー	3色表示灯(色・点滅・点灯はキー入力で変更可)
Option	
低歪み研削	
低歪み研削 スピンドル回転数	定格 : 36000 min ⁻¹ 最大 : 70000 min ⁻¹ (モーター単体)
スピンドル軸受け方式	エア軸受け方式
スピンドル駆動方式	高周波ビルトイン方式
ノッチ精研スピンドル回転数	150000 min ⁻¹
スピンドル軸受け方式	エア軸受け方式
スピンドル駆動方式	高周波ビルトイン方式
砥石形状 (外周精研)	
砥石外径 溝部	φ 46.6 ~ 42 mm
砥石外径 外周	φ 50 mm
砥石フランジ厚さ	15 mm
砥石形状 (ノッチ研削)	
砥石外径 溝部	φ 1.8 ~ 2.2 mm
砥石外径 外周	φ 3.8
砥石シャンク径	φ 3 mm

機構部仕様

ウェーハ厚さ測定	
分解能	1 μm
繰り返し測定精度	± 2 μm 以内
測定方法	非接触方式
アライメント機構	
方式	レーザー方式
分解能	1 μm
センタリング精度	± 50 μm 以内
研削テーブル直線軸 (X/Y/Z)	
分解能	1 μm
駆動方式	AC サーボモータとボールネジ
研削テーブル回転軸 (θ)	
分解能	0.001°
駆動方式	DD モータと高分解機構
研削テーブル平面度	
面振れ	10 μm 以下 / 360°
トランスファー部	
搬送方式	吸着搬送
真空発生源	真空エジェクタ
ウェーハ確認センサ	真空センサ
洗浄部	
洗浄方式	スピナ洗浄
乾燥方式	ドライエア乾燥
駆動方式	AC サーボモータ
回転数	500 ~ 1500 min ⁻¹
供給部・収納部	
方式	カセットキャリア方式 (オプションあり)
諸元	
装置の寸法・重量	2515 (W) x 1475 (D) x 2000 (H) / 2300*mm
W-GM-5200-3C	3040 (W) x 1775 (D) x 2000 (H) / 2300*mm 5000 kg *表示灯高さ
W-GM-5200-8C	3040 (W) x 1775 (D) x 2000 (H) / 2300*mm 5000 kg *表示灯高さ

株式会社 東精エンジニアリング

(本社)
〒 300-0006 茨城県土浦市東中貫町 4-6
TEL.029-830-1888 FAX.029-832-4053

(土浦工場 専用機事業部)
〒 300-0015 茨城県土浦市北神立町 2-14
TEL.029-830-1882 FAX.029-832-4053

海外拠点 OVERSEAS NETWORK



URL <http://www.toseieng.co.jp/>

C-97-061-J-1611